

同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告(二)

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司于 2011 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，同意为下属全资子公司南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币 20 亿元(或等值美元)的项目贷款额度提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币 20 亿元(或等值美元)的项目贷款额度提供担保。截止 2010 年 12 月 31 日，公司对南通同方半导体有限公司提供的担保余额为 0 万元。
- 对外担保累计数量：截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保余额为 30.43 亿元，占公司净资产的 38.09%，其中，为控股子公司的担保余额为 23.20 亿元，占公司净资产的 29.05%。
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为进一步拓宽南通半导体公司融资渠道，保证 LED 项目顺利进行，南通半导体拟向中国银行再申请人民币 20 亿元(或等值美元)的项目贷款额度，期限 8~10 年，并拟申请由公司为其项目贷款本息提供担保。

2011 年 4 月 6 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司同意为下属南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币 20 亿元(或等值美元)的项目贷款额度提供担保。

上述担保事宜董事会均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、被担保人基本情况

南通同方半导体有限公司是同方股份有限公司 2010 年 6 月投资成立的全资子公

司，位于江苏省南通市经济技术开发区内，利用南通同方科技园生产基地进行建设生产。南通半导体负责实施 LED 外延片、芯片的产业化生产项目。在消化吸收国际先进技术的基础上，计划在南通用三年的时间自主投资建成年产能 240 万片高亮度蓝绿光 LED 外延片生产线。截至目前，南通半导体处于筹建期。

截至 2010 年 12 月 31 日，南通同方半导体有限公司总资产为 5.56 亿元，负债总额为 0.56 亿元，资产负债率为 10.10%。2010 年，南通同方半导体有限公司完成营业收入 0 亿元。

三、董事会意见

董事会认为，上述担保系正常的经营安排，南通同方半导体有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

上述担保事项尚需股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保余额为 30.43 亿元，占公司净资产的 38.09%，其中，为控股子公司的担保余额为 23.20 亿元，占公司净资产的 29.05%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十五次会议决议

同方股份有限公司董事会
2011 年 4 月 8 日